

3D кремниевые фотонные структуры с оптическими межсоединениями через микроканальную пластину

Лазарук С. К. ¹,

Лешок А. А. ²,

Долбик А. В. ³,

Высоцкий В. Б. (Foreign) ⁴,

Шведов С. В. (Foreign) ⁵,

Солодуха В. А. (Foreign) ⁶,

Лабунов В.А. ⁷

2017

1, 2, 3, 7 Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск, Республика Беларусь

4, 5, 6 Foreign (ОАО «Интеграл», г. Минск, Республика Беларусь)

Источник публикации: 27-я Международная Крымская конференция «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (Крымико'2017, Севастополь, 10-16 сентября 2017 г.): материалы конф. – в 9 т. – Том 2. – С. 1947-1949.